

## W20 SOLDADURA EN PASTA SOLUBLE EN AGUA

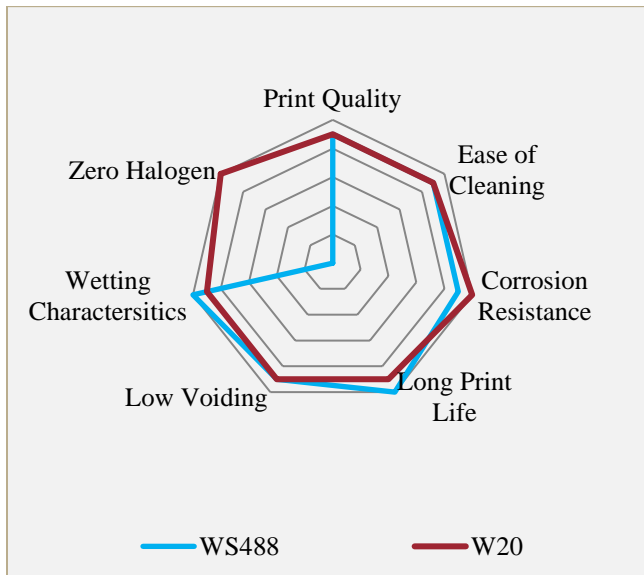
### CARACTERÍSTICAS

- Cero Haluros/Halógenos conforme a J-STD-004/B
- Cumple con las normas RoHS\*
- Lavado con agua desionizada (DI)
- Baja generación de espuma
- Ventana de limpieza extendida de más de 2 semanas
- Vida útil en estencil de +8hrs.

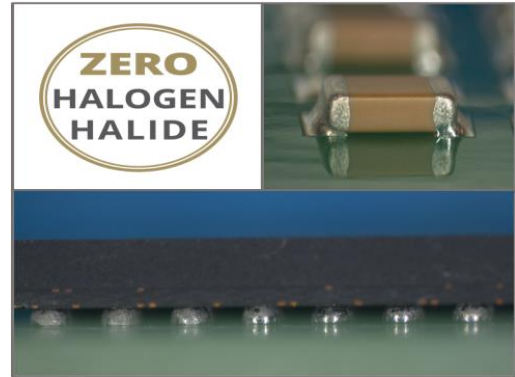
### DESCRIPCIÓN

La pasta para soldadura soluble en agua W20 de AIM es una fórmula de flux con cero haluros y halógenos. W20 ha sido diseñada para mejorar el rendimiento de humectación en todas las superficies electrónicas soldables. W20 exhibe excelentes características de impresión y una vida útil en el estencil de más de 8 horas. Los residuos altamente solubles de W20 se eliminan fácilmente con agua, incluso con componentes de bajo separación (stand-off). Este producto soluble en agua para todo tipo de aplicaciones fue creado para satisfacer la demanda de la industria de una pasta de soldadura soluble en agua con cero halógenos y consistente.

### CARACTERÍSTICAS



\*Para aleaciones sin Plomo.



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	6 meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	2 semanas	< 25°C (< 77°F)

No añada pasta usada a la pasta que no ha sido utilizada. Almacene la pasta usada por separado; mantenga la pasta no usada bien cerrada con el tapón interno o la tapa en su sitio. Una vez abierta, la vida útil de la pasta para soldar dependerá del entorno y de la aplicación. Consulte las guías de uso de las pastas de AIM para obtener más información. Las condiciones de aleación y almacenamiento pueden afectar a la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis W20 para obtener información específica del producto.

### LIMPIEZA

**Pre-Reflujo:** AIM DJAW-10 elimina eficazmente la pasta de soldadura W20 de los estenciles durante el proceso. DJAW-10 puede ser aplicado a mano o utilizado en equipos de limpieza de estenciles. DJAW-10 no secará W20 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplique en exceso DJAW-10. No aplicar DJAW-10 en la parte superior del estencil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede utilizar como un enjuague final del estencil.

**Residuos de Flux Post-Reflujo:** AIM recomienda limpiar el residuo de flux de la W20 dentro de 24 horas para resultados óptimos, pero puede ser retirado de la tablilla hasta 2 semanas después. La limpieza se puede realizar en agua corriente entre 50°C-60°C (120°F-140°F) seguido de un enjuague final en agua desionizada (DI).

## PERFIL DE REFLUJO


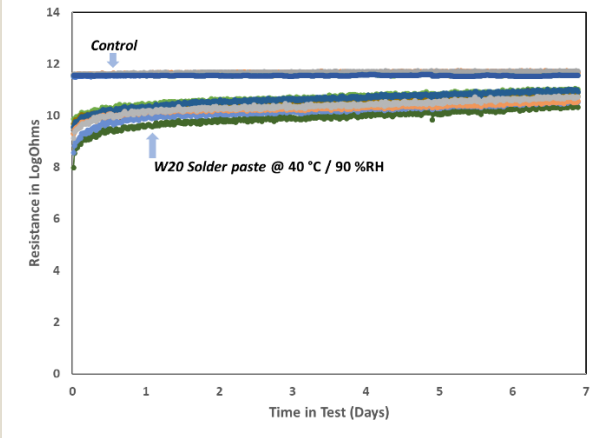
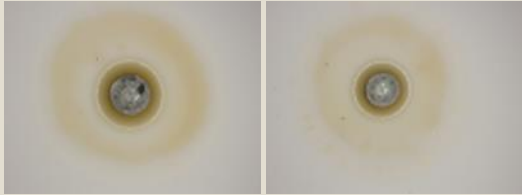
Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

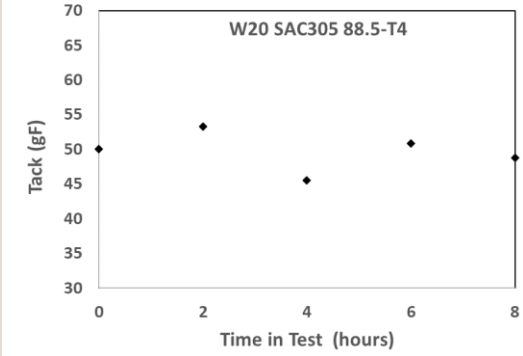
## IMPRESIÓN

Ajustes iniciales recomendados de la impresora - Dependiendo del diseño de la PCB y del Pad	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de espátula	0.30-0.60 kg/cm (1.7- 3.4 lb. /In.) de la hoja
Velocidad de la espátula	25-120 mm/seg. (1-4.7" /seg.)
Distancia de impresión (Snap-off)	En contacto 0.00 mm
Distancia de separación PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de separación PCB	3-6 mm/seg.

## DATOS DE PRUEBAS

Nombre	Método de Prueba	Resultados	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004 3.3	ORM0	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004B 3.3	ORM0	
Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	MED = < 50% Avance	@ 23 °C / 55 %RH
			 
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	 
			<p>Antes</p> <p>Después</p>
Halógeno	J-STD-004B 3.5.4 EN 14582	400 ppm Típico	Libre de Halógeno
Haluros cuantitativos	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	200 ppm Típico	Libre de Haluros

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	No detectado	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No Fluoruro	
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA, Todas las mediciones en los patrones de prueba exceden 100 MΩ	
Determinación del valor ácido	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	54.2 mgKOH/g flux Típico	
Viscosidad (Brookfield)	J-STD-004B 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	500 - 800 kcps Típico	
Viscosidad (Malcolm)	J-STD-004B 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	150 – 210 Pa.S Típico	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASA	
Depresión (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	 <p>15 minutos                      4 horas</p>

<p>Fuerza de Adhesión (Tack)</p>	<p>J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44</p>	<p>43.8 gf Típico</p>	 <table border="1"> <caption>W20 SAC305 88.5-T4 Tack Data</caption> <thead> <tr> <th>Time in Test (hours)</th> <th>Tack (gF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>50</td></tr> <tr><td>2</td><td>53</td></tr> <tr><td>4</td><td>46</td></tr> <tr><td>6</td><td>51</td></tr> <tr><td>8</td><td>49</td></tr> </tbody> </table>	Time in Test (hours)	Tack (gF)	0	50	2	53	4	46	6	51	8	49
Time in Test (hours)	Tack (gF)														
0	50														
2	53														
4	46														
6	51														
8	49														
<p>Humectación</p>	<p>J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45</p>	<p>PASA</p>													

† Uso sólo como referencia. No debe utilizarse como especificaciones de productos concretos.